POLISHING METHOD OF METAL MOLD MOUNTING SURFACE OF STAMPER AND POLISHING MACHINE THEREFOR

Patent number:

JP3234467

Publication date:

1991-10-18

Inventor:

AKINO SHOJI

Applicant:

CANON INC

Classification:

- international:

B24B37/04; B24B7/04; B24B49/12

- european:

Application number:

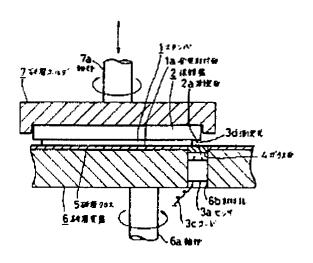
JP19900024393 19900205

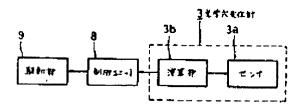
Priority number(s):

Abstract of JP3234467

PURPOSE:To highly shorten the time required from polishing start to finish by providing an arithmetic part of an optical displacement gauge for continually calculating and determining the measurement value of displacement quantity of a measuring surface orthogonal to a metal mold mounting surface on the basis of the measurement signal of a sensor.

CONSTITUTION:A value obtained by subtracting the determined thickness of a stamper 1 to be finished by polishing from the thickness of the stamper prior to polishing is taken as a polishing margin, and then polishing is started. The polishing quantity of the metal mold mounting surface 1a of the stamper 1 is continually measured by an optical displacement gauge 3 during polishing, and when the measurement value reaches the polishing margin, a polishing machine is stopped by a control unit 8.





Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−234467

@Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月18日

B 24 B 37/04 7/04 49/12 D 6581-3C B 7234-3C 7908-3C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

60発明の名称

スタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機

②特 願 平2-24393

20出 願 平2(1990)2月5日

@発明者 秋野 正二

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑪出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑩代 理 人 弁理士 若 林 忠

明 紐 藿

1. 発明の名称

スタンパの金型取付面の研磨方法およびそ の研磨機

2. 特許請求の範囲

1. 研磨機を使用するスタンパの金型取付面の研磨方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値 を研磨代寸法としたのち、前記研磨を開始し、

研磨中、光学式変位計により前記スタンパの金型取付面の研磨量を常時測定してその測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させることを特徴とするスタンパの金型取付面の研磨方法。

2. 保護盤に被着しているスタンパの金型取付面と研磨定盤に張られた研磨クロスとを互いに摺擦させる研磨機において、

前記金型取付面と平行に前記保護盤に形成された 加定面と、 該測定面に測定光を照射する前記研磨定盤に設置された光学式変位計のセンサと、

該センサの測定信号に基づいて前記金型取付面に垂直な方向の前記測定面の変位量の測定値を常時演算して求める前記光学式変位計の演算部

ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に違したときに前記研磨機を停止させる制御ユニットとを備えたことを特徴とするスタンパの金型取付面の研磨機。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、各種の情報信号が記録されたコンパクトディスクや光ディスク等の情報記録盤の複製
基板を成形するためのスタンパの研磨に関し、特に該スタンパをプレス用もしくは射出成形用の金型に取り付けるためのスタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機に関するものである。

[従来の技術]

従来、スタンパの金型取付面と研磨クロスとを

互いに摺擦させる研磨機を使用したスタンパの金 型取付面の研磨方法には、次のものがある。

まず、マイクロメータ、超音波厚さ計、渦電流厚さ計、光学式変位計等を用いて測定した研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さを減じて研磨代寸法を求める。

該研磨代寸法と経験的に求めておいた研磨レート(単位時間当たりの研磨量、例えば1.0 μ = / 分など。)とから、誤差を見込んで研磨時間を計算して前記研磨機のタイマーに設定する。

該タイマーにより研磨機が自動停止するまで前 記スタンパの金型取付面の研磨をする。

該研磨を終えたのち、スタンパを洗浄してその厚さを測定する。その測定値が前記所定のスタンパの厚さに違していれば研磨をそのまま終了し、そうでなければ前記研磨レートを修正して同じ工程を前記所定のスタンパの厚さに違するまで繰り返す。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するため、本発明のスタンパの 金型取付面の研磨方法は、

研磨機を使用するスタンパの金型取付面の研磨 方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値 を研磨代寸法としたのち、前記研磨を開始し、

研磨中、光学式変位計により前記スタンパの金型取付面の研磨量を常時測定してその測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させることを特徴とするものである。

本発明のスタンパの金型取付面の研磨機は、

保護盤に被着しているスタンパの金型取付面と 研磨定盤に張られた研磨クロスとを互いに摺擦させる研磨機において、

前記金型取付面と平行に前記保護盤に形成された測定面と、

該測定面に測定光を照射する前記研磨定盤に設置された光学式変位計のセンサと、

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、上記従来の技術の問題点に鑑みてなされたものであり、研磨を終えるたびに、スタンパの洗浄とその厚さの測定とを繰り返す必要のない、研磨時間の短いスタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機を提供することを目的とするものである。

該センサの測定信号に基づいて前記金型取付面に垂直な方向の前記測定面の変位量の測定値を常時演算して求める前記光学式変位計の演算部と、

ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に違したときに前記研磨機を停止させる制御ユニットとを備えたことを特徴とするものである。

[作用]

上記のように構成された本発明のスタンパの金 型取付面の研磨方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値である研磨代寸法は、スタンパの金型取付面が研磨により削り取られるべき寸法である。したがって、研磨中、光学式変位計によりスタンパの金型取付面の研磨量が常時測定されてその測定値が前記研磨代寸法に違したときに、前記所定のスタンパの厚さが得られる。

また、本発明のスタンパの金型取付面の研磨機

において、

測定面は、スタンパが被着している保護盤に形成されているので、該スタンパの金型取付面に垂直な方向の該測定面の変位量は、該金型取付面の研磨量である。

したがって、光学式変位計は、前記研磨量を 常時測定してその測定値を求めていることにな る。

制御ユニットに前記研磨代寸法を設定して研磨を開始すると、該制御ユニットは前記測定値が前記研磨代寸法に達したときに研磨機を停止させるので、所定のスタンパの厚さが得られる。

[実施例]

本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

まず、本発明の方法の実施に使用するスタンパの金型取付面の研磨機の第1実施例について説明する。

第 1 図および第 2 図において、スタンパ 1 は、情報信号をカッティングしたガラス原盤上にニッケルを 500 ~ 2000 A の厚さに蒸着して導電化し

る。

また、該研磨ホルダ7は、前記研磨定盤6の回転中心軸とずれた位置にその回転中心軸があり、研磨定盤6が回転することにより、その回転とは反対回りの回転をする。これにより前記スタンパ1の金型取付面1aと前記研磨クロス5とが互いに摺擦して研磨される。該研磨に際しては、液体の研磨剤が設定された割合で前記研磨クロス5に滴下される。

測定面2aは、前記保護盤2のスタンパ1が被 着している面より外側の面に環状に形成されてお り、前記金型取付面1aと平行で前記研磨クロス 5 に対向している。

ガラス版4は、前記研磨定盤6に張られた研磨クロス5の表面からわずかに後退してほぼ同一平面を形成するように該研磨定盤6の適宜部位に形成された取付孔6bに嵌着されており、その表面は前記研磨クロス5が張られることなく露出している。

光学式変位計(例えば、株式会社キーエンス製

た後、その上に電鏡によりニッケルを305~330 μョの厚さに電着して形成したものであり、前記 ガラス原盤そのものである円盤状の保護盤 2 に剥 離されずにそのまま被着されている。また、該ス タンバ1の金型取付面1 a は、研磨定盤 6 に張ら れた研磨クロス5 に当接する。

前記研磨定盤6は、図示しない研磨機本体(以下、単に「本体」という。)に回転可能に設置されており、その軸部6aは、電動モータ等から構成される本体に設けられた駆動部9の出力軸に接続され、設定された回転数で研磨定盤6を回転させる。

一方、本体に着脱かつ回転自在に装着された軸部 7 a を有する円盤状の研磨ホルダ 7 は、図示しない移動機構により軸方向に移動自在であり、前記保護盤 2 のスタンパ 1 が被着している面と反対側の全面を前記研磨定盤 6 に対して設定された圧力で均一に押圧可能である。また、該研磨ホルダ 7 には図示しない吸盤が埋設されており、該吸盤により前記保護盤 2 を吸着することにより保持す

の光学式変位センサ P A シリーズ。) 3 のセンサ 3 a は、前記取付孔 6 b の前記ガラス板 4 より下 方に嵌著されており、その測定光 3 d は、該ガラス板 4 を透過して前記測定面 2 a を照射可能である

前記測定光3 d は、研磨定盤6の回転に伴って移動し、1回転する間に前記測定面2 a と 2 回交差するので、その交差のたびに該測定面2 a を照射することになる。

前記センサ3aはコード3cおよび不図示のス リップリング等を介して前記光学式変位計3の痕 算部3bに接続されている。

該演算部3bは、前記センサ3aの測定信号に 基づいて前記金型取付面1aに垂直な方向の前記 測定面2aの変位量の測定値を常時演算して求・ め、制御ユニットBに入力するものである。

本体に設けられた該制御ユニット8は、ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に違したときに前記駆動邸9を停止させて研磨を終了させる機能を有する公知のものであ

る。

つぎに、本実施例を用いたスタンパの金型取付 面の研磨方法の実施例について説明する。

まず、研磨前のスタンパ1の厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さ、例えば 295 μm を減じて得た値を研磨代寸法として制御ユニット 8 に設定する。

1 が被着している面と反対側の全面を当接させて 該保護盤2を吸着により保持させ、酸化アルミニ ウム研磨剤(例えば、商品名ポリブラ700。)を毎 分50mlの割合で研磨クロス5に満下させ始め る。その後、前述した移動機構を操作して前い 磨ホルダ7を移動させ、スタンパ1の金型取付 度ホルダ7を移動させ、スタンパ1の金型取付 は、光学式変位計3のセンサ3aの測定光3dの 生、光学式変位計3のセンサ3aの測定光3dの 焦点調整を行なう。その状態で研磨定盤6を駆動 部9により回転数60rpmで回転させ研磨を開始 する。

研磨中、光学式変位計3の演算部3bは、前

る。

上記第1実施例では電貨に用いたガラス原盤をそのまま保護盤2として使用する例を示したが、本実施例では第3図に示すように、ガラス原盤と同様の大きさの円盤状のガラス板を保護盤22として使用している。電賃後、スタンパ21を対径を所し、ついで該スタンパ21の情報にの寸法に切断し、ついで該スタンパ21の情報につけ法に切断し、ついで該スタンパ21の情報については接着剤22bを全布し、該スタンパ21を該接着剤22bを介して前記保護盤22に被着させている。その他の点は第1実施例と同様である。

また、保護盤に接着剤を介して被着している研 磨前のスタンパの厚さを超音波厚さ計により測定 してその厚さが 3 1 8. μ α であったものを、研磨代 寸法を 2.3 μ α として設定し、さらに研磨剤の摘 下割合、研磨ホルダ 7 の圧力および研磨定盤 6 の 回転数の値をそれぞれ第 1 実施例と同一に設定して研磨をしたところ、研磨開始から終了までに要 した時間は 2.2 分間であった。研磨後のスタンパ 記センサ 3 a の 測定信号に基づいて、 金型取付面 1 a に垂直な方向の 測定面 2 a の変位量の 測定値を常時演算して求め、 前記制御ユニット 8 に入力する。 該制御ユニット 8 は、前記測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記駆動部 9 を停止させ 研磨を終了させる。

また、ガラス原盤に被着している研磨前のスタンパの厚さを超音波厚さ計により測定してその厚さが320 μm であったものを、上記方法に従って、研磨代寸法を25μm と設定して研磨をしたところ、研磨開始から終了までに要した時間は28分間であった。また、研磨後のスタンパの厚さを前記超音波厚さ計で数個所測定してみたところ、294~296 μm の値が得られた。

なお、前記所定のスタンパの厚さは 295 μα に限る必要はなく、また、前記研磨剤の滴下割合、研磨ホルダ 7 の圧力および研磨定盤 6 の回転数は、上記以外の適宜値にそれぞれ設定可能である。

本発明の研磨機の第2実施例について説明す

の厚さを前記超音波厚さ計で数個所測定してみた ところ、293~297 μm の値が得られた。

つぎに、本発明の第1 および第2 実施例と比較 するために行なった、従来の技術の欄で説明した 方法によるスタンパの金型取付面の研磨の一例に ついて説明する。

・ついで、前記研磨レートを0.7 μα /分に修正

し、あらたに研磨時間を1.5分として研磨機のタイマーに設定し、再び同様に研磨を開始した。研磨機が停止したのち、スタンパを洗浄してその厚さを前記超音波厚さ計で測定したところ、291 μ α であった。

研磨開始から終了までに要した時間は、全体で 50分であり、研磨終了時のスタンパの厚さは前 記目標値より4μm 薄く仕上がった。

以下に本発明の各実施例と従来の技術の欄で 説明した方法とを比較した結果について説明する。

本発明の第1実施例に示したスタンパの厚さの 仕上寸法は、294~296 μm であり、また第2実 施例のそれは、293~297 μm であり、従来の方 法に比較して仕上寸法精度が高い。また、研磨開 始から終了までに要する時間も、第1実施例では 28分間、第2実施例では22分間であり、従来 の方法に比較して非常に短い。

なお、第1 および第2 実施例では、スタンパの 代りにガラス版やシリコンウエハー等を研磨する

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の第1 実施例の要部断面図、第2 図は本発明の第1 および第2 実施例の構成を説明するためのブロック図、第3 図は本発明の第2 実施例の要部断面図である。

1.21 … スタンパ、

1 a, 2 1 a ··· 金型取付面、

2.22…保護盤、

3 … 光学式変位計、

3 a … センサ、

3 b … 演算部、

3 c -- = - K.

4 … ガラス板、

5 … 研磨クロス、

6 … 研磨定盤、

6 b ··· 取付孔、

7 … 研磨ホルダ、

8…制御ユニット、

9 … 驅動部。

特許出願人 キャノン株式会社 代 埋 人 弁理士 若 林 忠 ことも可能であり、同様の仕上寸法精度が確保で きる。

[発明の効果]

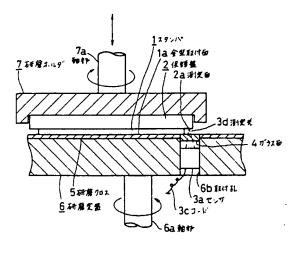
本発明は、以上説明したとおり構成されているので、以下に記載するような効果を奏する。

光学式変位計は、研磨を中断せずに研磨中のスタンパの金型取付面の研磨量を常時測定することができる。

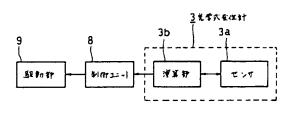
これにより、従来の如く経験的に求める研磨 レートを採用した研磨と該研磨後のスタンパの厚 さの測定とを繰り返し行なう必要がなくなるの で、研磨開始から終了までに要する時間が大幅に 短縮できる。

また、前記測定が不必要となるので洗浄時ある いは測定時にスタンパに傷が付くことがなくな る。

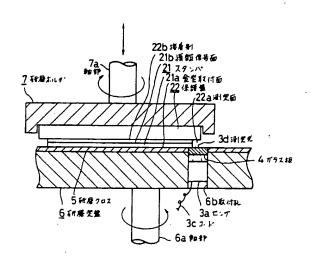
さらに、不確定な前記研磨レートではなく測定 分解能の高い光学式変位計を使用するので、スタ ンパの厚さの仕上寸法精度を高めることができ、 過剰研磨によるスタンパの不良発生も防止でき



第 1 図



第 2 図



第 3 図